

長華電材及長華科技聯合授信案簽約新聞稿

發稿單位：長華電材股份有限公司

發稿時間：106年1月20日

主旨：長華電材股份有限公司及旗下子公司長華科技股份有限公司分別與臺灣銀行等6家銀行完成新臺幣28.5億元及40億元聯合授信案簽約

說明：

長華電材股份有限公司（以下簡稱長華電材）及旗下子公司長華科技股份有限公司（以下簡稱長華科技）分別委由臺灣銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，邀集彰化商業銀行、華南商業銀行、永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行及國泰世華商業銀行參加之新臺幣28.5億元及40億元聯合授信案，已於106年1月20日完成聯貸簽約。簽約儀式假長華科技舉行，由公司董事長黃嘉能與臺灣銀行總經理魏江霖共同主持。

長華電材之聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，長華科技之聯合授信案主要用途則為支應向日商SH Materials Co., Ltd.(以下簡稱S.H.M) 購買其轉投資公司新加坡商SH Asia Pacific Pte. Ltd.(以下簡稱SHAP)股份暨充實中期營運週轉金。

長華科技成立於98年12月24日，主要產品為Pre-Mold(預成型)金屬基板，係結合長華電材在封裝樹脂與Molding(鑄模)的專業所發展而成之Pre-mold(預成型)技術，不僅可以將金屬導線架封裝的良率與效率大幅提升，更可以發展高階金屬導線架產品，突破原本金屬導線架使用上之限制。

長華集團透過此次收購案的垂直整合，除了在上游原料上直接獲得S.H.M的材料支援外，並可承接現有S.H.M之整合元件製造廠 (IDM: Integrated Device Manufacture)客戶，

再加上長華電材原有的OSATs客戶(專業封裝測試公司)，將具備完整之客戶出海口，為金屬導線架封裝領域，帶來一個全新的應用與更具競爭力的產品。長華集團期許能成為全球主要半導體基板供應商之一，為半導體產業持續貢獻心力。

目前長華電材及長華科技聯合向S.H.M購買其轉投資公司新加坡商SHAP股份已進入行政申請程序中，正待投審會以及公平會核准。此次聯合授信案順利簽約完成，將厚實台灣在全球半導體封裝材料之競爭力，並可開創台灣半導體競爭優勢。

若需要更進一步訊息，請聯絡
董事長室 經理 蘇雙富 Richie
電話：(02) 8751-0696 分機 206
E-mail：richie.su@cwei.com.tw